

### W20 SOLDADURA EN PASTA SOLUBLE EN AGUA

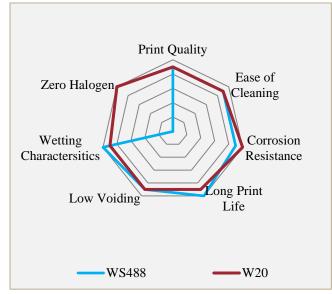
### **CARACTERÍSTICAS**

- Cero Haluros/Halógenos conforme a J-STD-004/B
- Cumple con las normas RoHS\*
- Lavado con agua desionizada (DI)
- Baja generación de espuma
- Disponible en tamaños de polvo T4 y T5
- Ventana de limpieza extendida a más de 2 semanas
- Vida útil en esténcil de +8hrs.

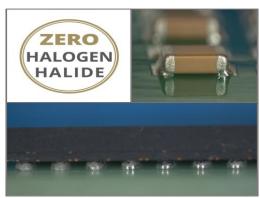
#### **DESCRIPCIÓN**

La pasta para soldadura soluble en agua W20 de AIM es una fórmula de flux con cero haluros y halógenos. W20 ha sido diseñada para mejorar el rendimiento de humectación en todas las superficies electrónicas soldables. W20 exhibe excelentes características de impresión y una vida útil en el esténcil de más de 8 horas. Los residuos altamente solubles de W20 se eliminan fácilmente con agua, incluso con componentes de bajo separación (stand-off). Este producto soluble en agua para todo tipo de aplicaciones fue creado para satisfacer la demanda de la industria de una pasta de soldadura soluble en agua con cero halógenos y consistente.

### **CARACTERÍSTICAS**



<sup>\*</sup>Para aleaciones sin Plomo.



#### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

| Parámetro                                    | Tiempo     | Temperatura          |
|--|------------|----------------------|
| Vida útil de pasta cerrada<br>y refrigerada  | 6 meses*   | 0°C-12°C (32°F-55°F) |
| Vida útil de pasta cerrada<br>no refrigerada | 2 semanas* | < 25°C (< 77°F)      |

<sup>\*</sup> Tamaño del polvo T4. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la vida útil de T5.

No añada pasta usada a la pasta que no ha sido utilizada. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta no usada bien cerrada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Una vez abierta, la vida útil de la pasta para soldar dependerá del entorno y de la aplicación. Consulte las guías de uso de las pastas de AIM para obtener más información. Las condiciones de aleación y almacenamiento pueden afectar a la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis W20 para obtener información específica del producto.

### **LIMPIEZA**

Pre-Reflujo: AIM DJAW-10 elimina eficazmente la pasta de soldadura W20 de los esténciles durante el proceso. DJAW-10 puede ser aplicado a mano o utilizado en equipos de limpieza de esténciles. DJAW-10 no secará W20 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplique en exceso DJAW-10. No aplicar DJAW-10 en la parte superior del esténcil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede utilizar como un enjuague final del esténcil.

Residuos de Flux Post-Reflujo: AIM recomienda limpiar el residuo de flux de la W20 dentro de 24 horas para resultados óptimos, pero puede ser retirado de la tablilla hasta 2 semanas después. La limpieza se puede realizar en agua corriente entre 50°C-60°C (120°F-140°F) seguido de un enjuague final en agua desionizada (DI).

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

Document Rev #NF4

WWW.AIMSOLDER.COM INFO@AIMSOLDER.COM Page 1 of 4

<sup>\*</sup>Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

## **FICHAS TÉCNICAS**



### PERFIL DE REFLUJO

Se puede hallar información de perfil detallada en http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

### **IMPRESIÓN**

| Ajustes iniciales recomendados de la impresora - Dependiendo del diseño de la PCB y del Pad |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Parámetro   | Configuración Inicial Recomendada              |  |  |
| Presión de espátula   | 0.30-0.60 kg/cm (1.7- 3.4 lb. /In.) de la hoja |  |  |
| Velocidad de la espátula  | 25-120 mm/seg. (1-4.7" /seg.)                  |  |  |
| Distancia de impresión (Snap-off)   | En contacto 0.00 mm                            |  |  |
| Distancia de separación PCB   | 0.75 - 2.0 mm                                  |  |  |
| Velocidad de separación PCB   | 3-6 mm/seg.                                    |  |  |

### **DATOS DE PRUEBAS**

Nota: Todos los datos de ensayo corresponden a la formulación T4 SAC305.

| Nombre                    | Método de<br>Prueba                          | Resultados            |                                     |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Clasificación IPC<br>Flux | J-STD-004 3.3                                | ORM0                  |                                     |
| Clasificación IPC<br>Flux | J-STD-004B 3.3                               | ORM0                  |                                     |
| Nombre                    | Método de<br>Prueba                          | Resultados            | Imagen                              |
| Espejo de Cobre           | J-STD-004B 3.4.1.1<br>IPC-TM-650 2.3.32      | MED = < 50%<br>Avance | @ 23 °C / 55 %RH  W20 Flux  Control |
| Corrosión                 | J-STD-004B 3.4.1.2<br>IPC-TM-650 2.6.15      | PASA                  | Antes Después  Output  Después      |
| Halógeno                  | J-STD-004B 3.5.4<br>EN 14582                 | 400 ppm<br>Típico     | Libre de Halógeno                   |
| Haluros<br>cuantitativos  | J-STD-004B 3.4.1.3<br>IPC-TM-650<br>2.3.28.1 | 200 ppm<br>Típico     | Libre de Haluros                    |

<sup>\*</sup>Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**GONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

## **FICHAS TÉCNICAS**



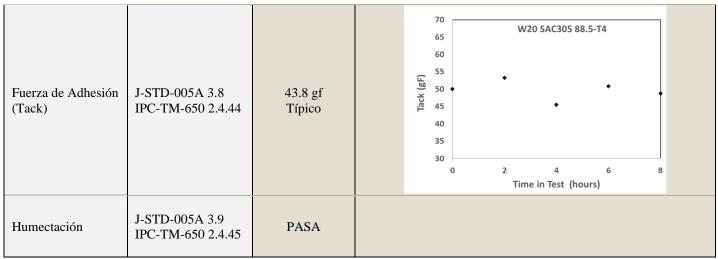
| Nombre                                   | Método de<br>Prueba                          | Resultados   | lmagen  |
|--|--|--|---|
| Cualitativa Haluros,<br>Cromato de Plata | J-STD-004 3.5.1.1<br>IPC-TM-650 2.3.33       | No detectado   |   |
| Cualitativa Haluros,<br>Fluoruro Punto   | J-STD-004B 3.5.1.2<br>IPC-TM-650<br>2.3.35.1 | No Fluoruro  |   |
| Resistencia Aislante<br>de la Superficie | J-STD-004B 3.4.1.4<br>IPC-TM-650 2.6.3.7     | PASA,<br>Todas las<br>mediciones en<br>los patrones de<br>prueba exceden<br>100 MΩ | Control  W20 Solder paste @ 40 °C / 90 %RH  W20 Solder paste @ 40 °C / 90 %RH  2  0 0 1 2 3 4 5 6 7 Time in Test (Days) |
| Determinación del valor ácido            | J-STD-004B 3.4.2.2<br>IPC-TM-650 2.3.13      | 54.2 mgKOH/g<br>flux<br>Típico   |   |
| Viscosidad<br>(Brookfield)               | J-STD-004B 3.4.2.4<br>IPC-TM-650 2.4.34      | 500 - 800 kcps<br>Típico   |   |
| Viscosidad<br>(Malcolm)                  | J-STD-004B 3.4.2.4<br>IPC-TM-650 2.4.34      | 150 – 210 Pa.S<br>Típico   |   |
| Visual                                   | J-STD-004B 3.4.2.5                           | PASA   |   |
| Depresión (slump)                        | J-STD-005A 3.6<br>IPC-TM-650 2.4.35          | PASA   |   |
| Bola de soldadura                        | J-STD-005A 3.7<br>IPC-TM-650 2.4.43          | PASA   | 15 minutos 4 horas  |

<sup>\*</sup>Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

# FICHAS TÉCNICAS





<sup>&</sup>lt;sup>+</sup>Uso sólo como referencia. No debe utilizarse como especificaciones de productos concretos.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

<sup>\*</sup>Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.